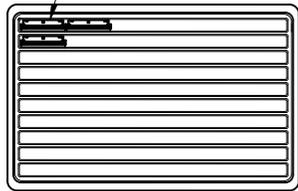


# HSF



产品凸点或卡点朝同一方向放置



No. 1

产品装入真空盒内  
真空盒规格:SB-25AB(300\*190\*6mm)



No. 2

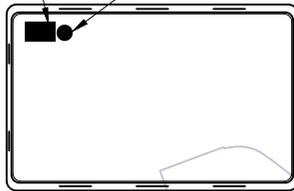
盖上盒盖并四边六处钉上订书针

物料	
品名	
数量	
日期	

数量标签



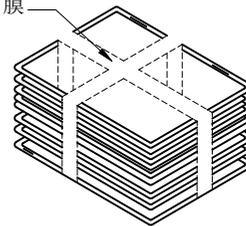
ROHS 标签



No. 3

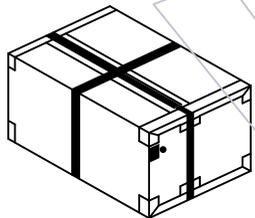
贴标签于真空盒左上角

缠PE膜



No. 4

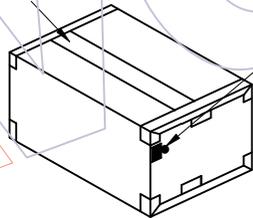
25盒为一扎,再用PE膜缠绕成十字形  
注意:产品凸点或卡点朝同一方向



No. 7

打包装带

大透明胶

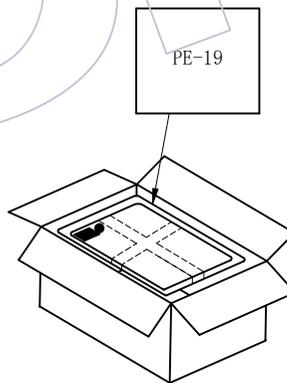


No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角

WCON 伟峰五金电子有限公司		3
货品标示单		
WCON料号	HSF	
客户料号		
品名		
最小包装量	PCS	
包装数量	PCS	

贴外箱标签及ROHS 标签



No. 5

纸箱内需套防水袋PE-19,再将真空盒装入纸箱  
(1扎/箱)加一包干燥剂后,将PE袋封口  
纸箱规格:CTN-20(双坑K=K,30\*25\*21cm)

2.0 IDC Socket					
规格	真空盒装数量	每箱装总数量	规格	真空盒装数量	每箱装总数量
6P	210	5250	30P	70	1750
8P	180	4500	32P	70	1750
10P	160	4000	34P	60	1500
12P	140	3500	36P	60	1500
14P	130	3250	38P	60	1500
16P	120	3000	40P	50	1250
18P	110	2750	42P	50	1250
20P	100	2500	44P	50	1250
22P	90	2250	46P	50	1250
24P	80	2000	48P	50	1250
26P	80	2000	50P	40	1000
28P	70	1750			

说明:

1. 产品如图所示形态放入真空盒
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型。

变更记事

版次	日期	变更说明	变更	核准
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A0	2019/06/24	NEW		

零件图	
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
Angle	
X.	± 2°
DIM	TOL

颜色	———
COLOR	———
材质	———
MATERIAL	———
设计	刘胜
DESING	2019/06/24
审核	
CHECK	
核准	
APPROVE	

SCALE	fit
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

## WCON

WCON Hardware Electronics Co.,Ltd

料号 PART NO. 5226-XXYPXXBX0X

品名 TITLE: 2.0 IDC Socket, 包装规范